



省資源、軽量化

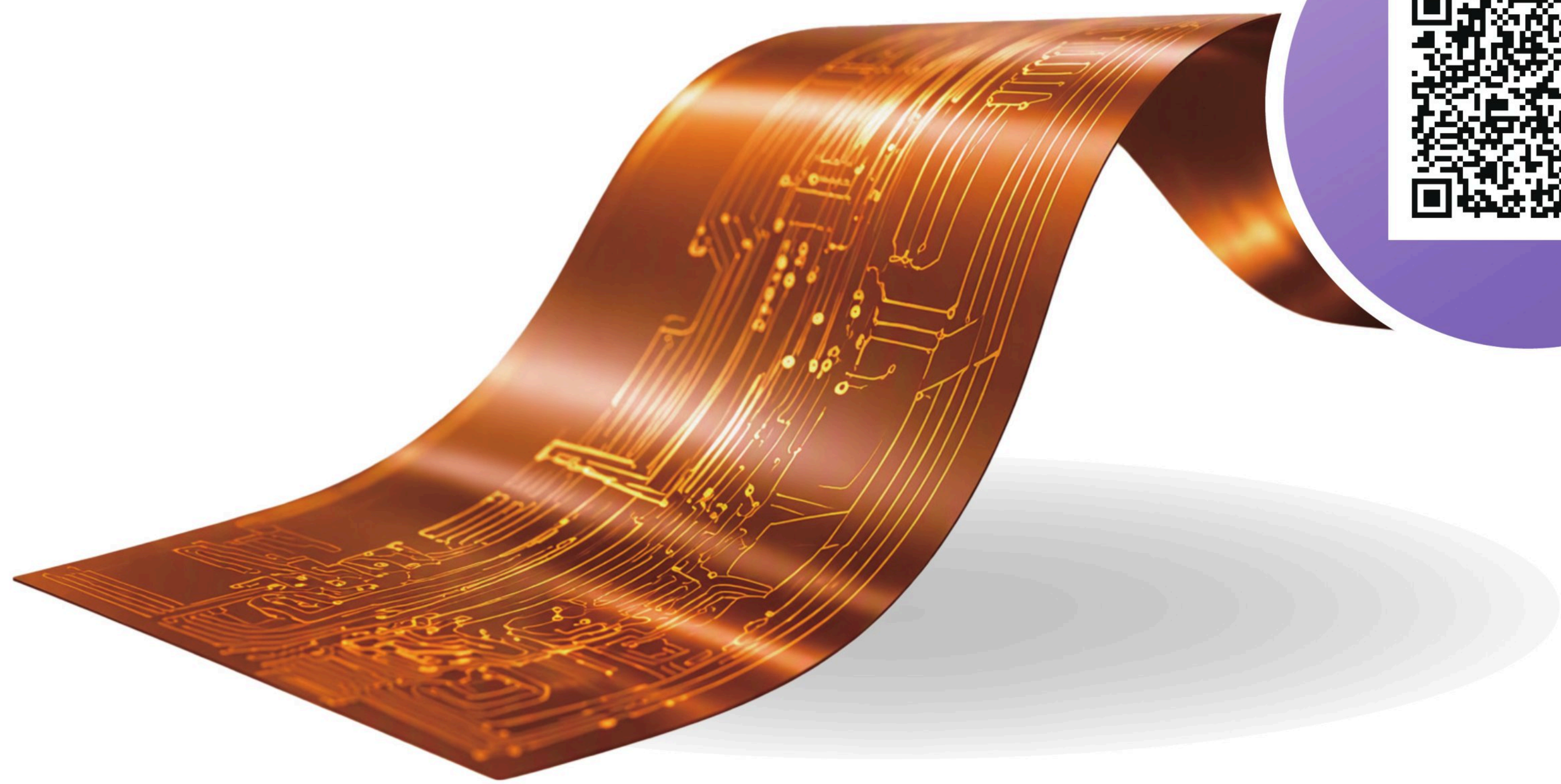
UPILEX®-NVT/NVF

UBE Transform Tomorrow Today

持続可能なエレクトロニクスを支えるポリイミドフィルム

Polyimide Films Supporting Sustainable Electronics UPILEX®-NVT/NVF

Thin.  
Strong.  
Sustainable.  
薄く、強く、長く使う。



#### 省資源

薄膜化による材料使用量削減、小型・軽量化に貢献

#### 製造ロス削減

耐薬品性・機械特性に優れ、歩留まり向上と廃棄物削減に貢献

#### 長寿命化

高耐熱性と長期信頼性で、電子機器の長寿命化を支援

#### 軽量化

軽量フレキシブル基板で、省エネルギー・高効率に貢献

#### 構造革新

リジッド基板からの置き換えで、基板構造を変える新たな可能性

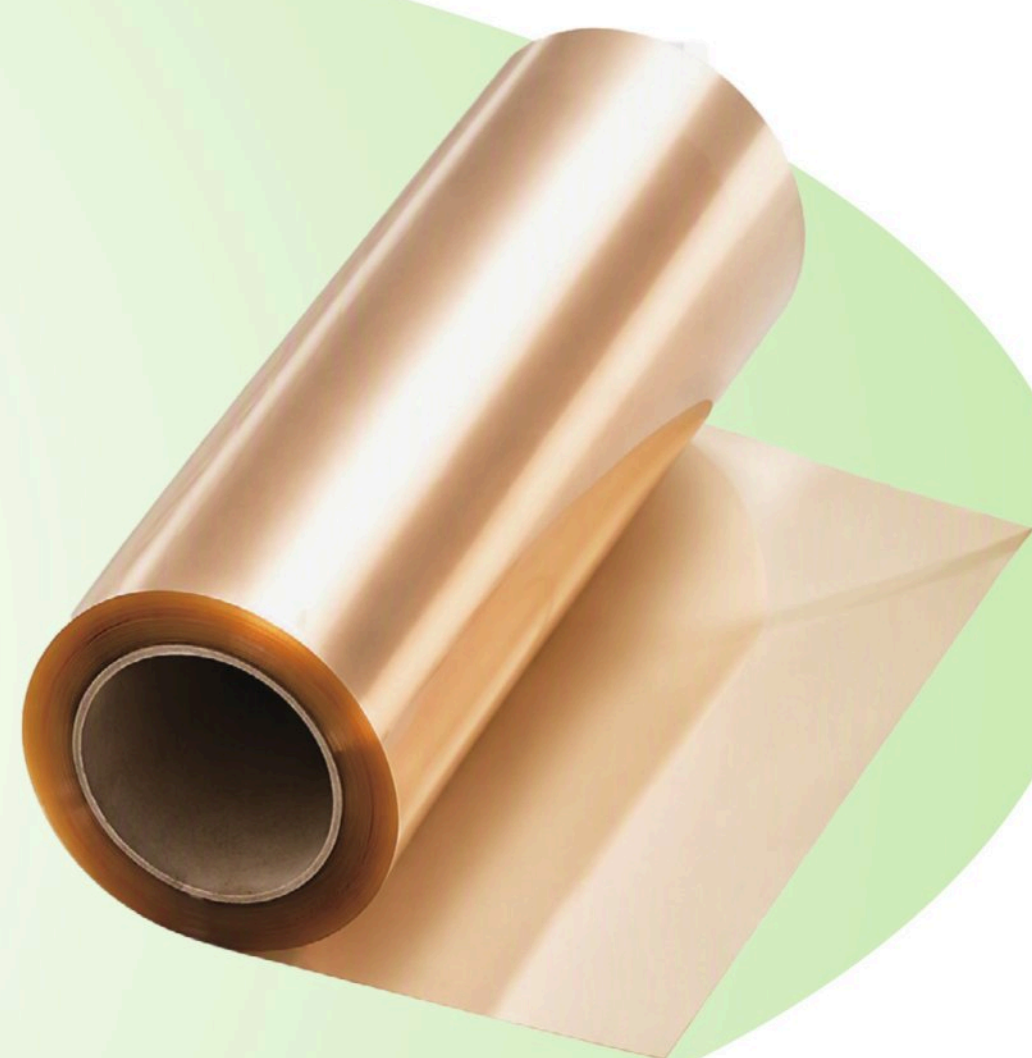
### 製品ラインナップ

2つの厚みで、異なる価値を。  
用途に応じて最適な性能を提供します。

9 $\mu$ m TPI

#### 超薄膜TPI

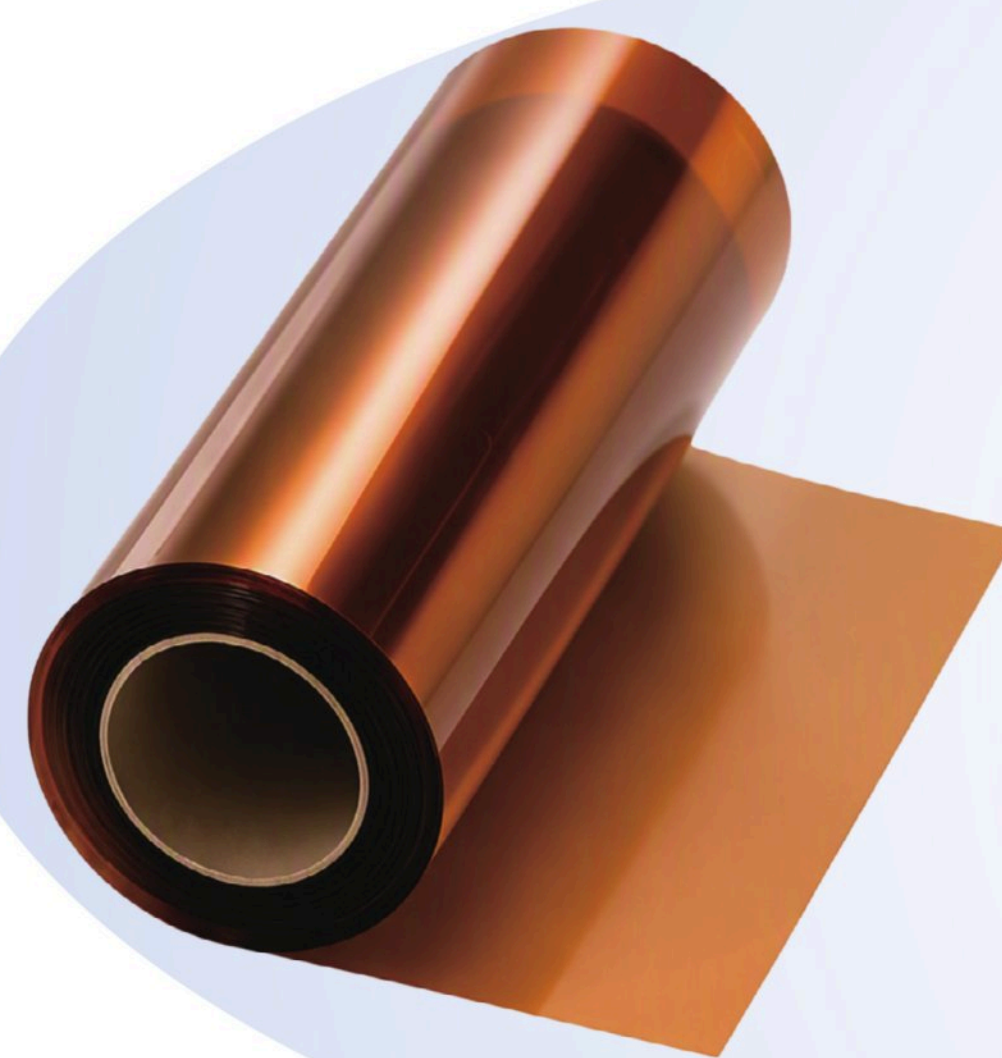
- 極薄・軽量  
超薄膜で省スペース化と軽量化を実現
- 高い屈曲性  
繰り返しの折り曲げにも優れた信頼性を発揮
- 微細加工対応  
極薄化により微細配線と高密度実装をサポート



75 $\mu$ m TPI

#### 超厚膜TPI

- 高い寸法安定性  
厚膜による高剛性で安定した基板構造を実現
- 高耐熱・高絶縁  
高温環境や高電圧用途で優れた絶縁信頼性を確保
- リジッド代替  
高剛性によりリジッド基板の代替を可能に



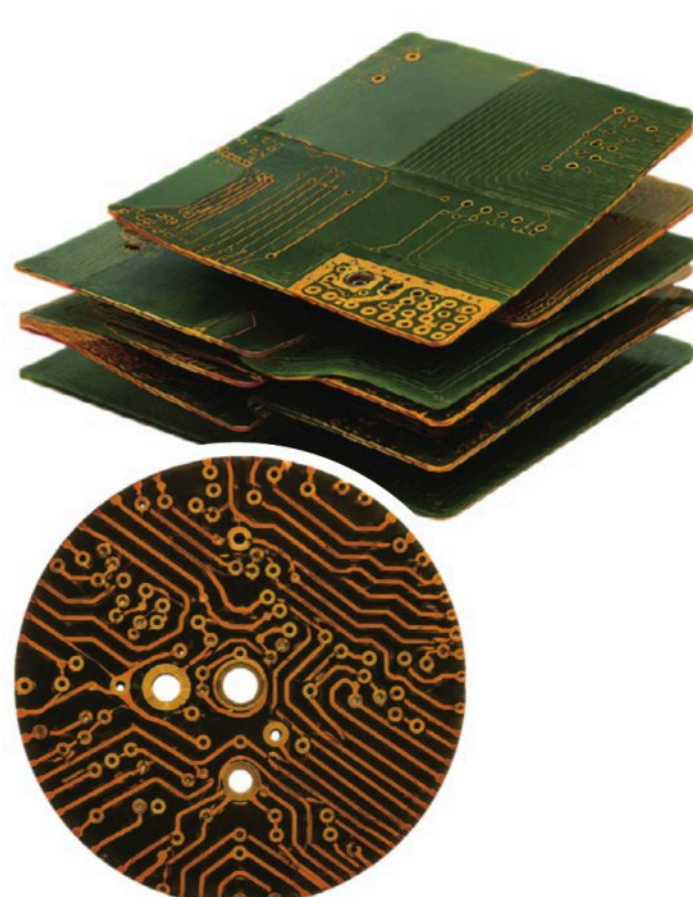
#### 用途例

##### 高密度FPC



- ・OLEDディスプレイ接続FPC
- ・カメラモジュールFPC
- ・バッテリーFPC
- ・折り曲げ部を持つ狭ピッチFPC

##### FCCL基材の薄膜化



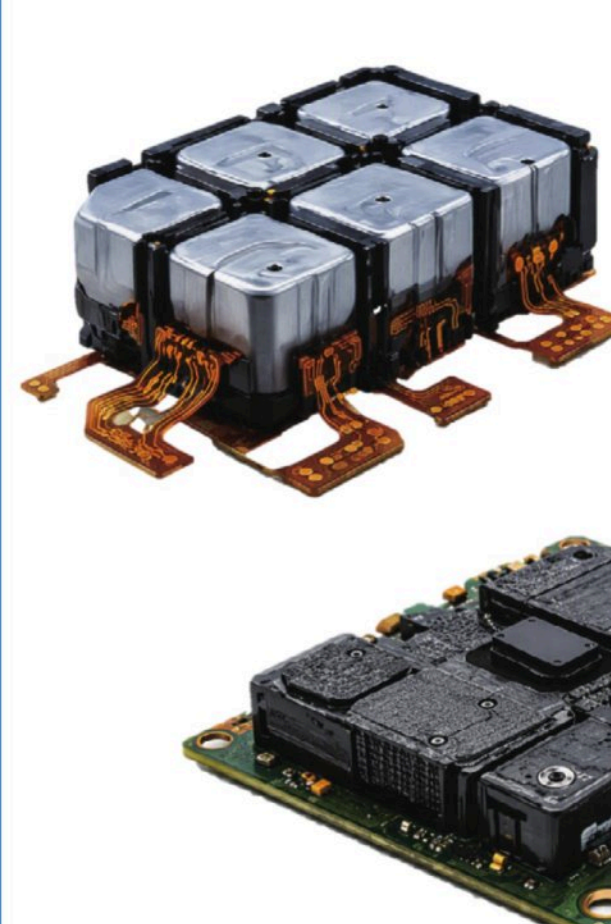
- ・FCCL総厚削減
- ・微細配線対応 (L/S微細化)
- ・軽量化

##### 折り曲げ信頼性重視



- ・ヒンジ周辺配線
- ・ウェアラブル機器

##### EV・BMS



- ・バッテリーマネジメントシステム(BMS)
- ・セル接続部
- ・バスバー絶縁

##### 産業機器



- ・サーボモータ
- ・インバータ
- ・産業機器基板

##### 車載



- ・先進運転支援システム(ADAS)
- ・パワートレイン周辺
- ・電子制御ユニット(ECU)

##### 高耐熱・高絶縁



- ・放熱と絶縁を両立したFPC
- ・高電圧回路

● Less Material. ● Less Waste. ● More Performance. ● More Possibilities.

より少ない資源で、ものづくりのロスを減らし、基板構造を変える新たな可能性を。